



三井金属

2017年10月31日

各 位

キャリア付極薄銅箔の第一弾増強工事完了のお知らせ

～マレーシア工場にて第一弾増設設備の稼働開始～

当社（社長 西田計治）は、銅箔を製造しているマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD. 以下 MCF）において、キャリア付極薄銅箔の第一弾設備増強工事が完了いたしましたのでお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した1.5μm～5μmの銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、1,300mmまでの広幅でロール出荷ができる事、ならびにキャリア剥離強度の安定性に優れている事などから、お客様の生産性向上と工程歩留向上に寄与できるため、高くご評価をいただいております。

MicroThin™は、従来のパッケージ基板用途に加え、新規用途としてスマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）での適用が始まっており、今後も需要の拡大が見込まれる事から、2016年11月28日のプレスリリースのとおり、第一弾としてMCFの生産体制を月産60万㎡から月産120万㎡へ増強することを決定し、2017年1月に工事を着工いたしました。

工事の完了は2018年1月の予定でしたが、旺盛な需要に応えるべく計画を前倒しで完了し、2017年10月より稼働を開始いたしました。これにより当社のMicroThin™生産体制は、上尾事業所の月産150万㎡と合わせて月産270万㎡となりました。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持するとともに、お客様への十分な供給能力を確保してまいります。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp